CLIPPEDIMAGE= JP361171147A

PAT-NO: JP361171147A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 61171147 A

TITLE: COORDINATE INSPECTION OF WAFER MAP

PUBN-DATE: August 1, 1986

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

IIZUKA, TSUNEO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

FUJITSU LTD

N/A

APPL-NO: JP60012156

APPL-DATE: January 25, 1985

INT-CL_(IPC): H01L021/66 US-CL-CURRENT: 324/754

ABSTRACT:

PURPOSE: To enable the correction of wafer maps by a method wherein each coordinate is judged whether finished in measurement (state of '1') or unfinished in measurement (state of '0') through inspection of coordinates determined in the direction of advancement of a probe card, and the result is compared with pre-determined patterns of '1' and '0'.

CONSTITUTION: In the case of the upward movement of a probe card 12 in the Y-axis, when the coordinate of a chip under measurement is (x, y) in a wafer map 13, chips finished in measurement from among adjacent chips lie each at coordinates (y+1, x-1), (y, x-1), (y-1, x-1), (y-1, x), and chips unfinished in measurement lie each at coordinates (y+1, x+1), (y, x+1), (y-1, x+1), (y+1, x). Therefore, if all the vertically reverse L-shaped patterns are '1' and all of the laterally reverse ones are '0' around a chip under measurement, the result of measured chips is registered at right positions of the wafer map 13, and it is possible to completely inspect the address shift of the wafer map 13.

COPYRIGHT: (C)1986, JPO& Japio

①特許出願公開

昭61 - 171147 ⑫公開特許公報(A)

@Int_Cl.4

庁内黎理番号 識別記号

④公開 昭和61年(1986)8月1日

H 01 L 21/66

7168-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

69発明の名称

ウェハマップの座標点検方法

頤 昭60-12156 创特

恒 夫

頭 昭60(1985)1月25日 御出

79発 明 者 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社 の出 関

弁理士 松岡 宏四郎 20代 理 人

聑

1.発明の名称

ウェハマップの座標点検方法

2. 特許請求の範囲

プロパー、プローブカード、テスタを用いてウ エハ測定をなしその結果をウエハマップに書き込 むにおいて、測定チップの座標を、当該チップの 周囲のL字型判定パターンに測定データが入って いるか否かによって点検し、座標ずれがあるとき は前記し字型判定パターンによって修正すること を特徴とするウエハマップの座標点検方法。

3.発明の辞細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はウエハマップの座標点検方法、より群 しくはプロパー、プローブカード、テスタ等を用 いてなすウェハマップを利用するウェハの各チッ プの検査のための測定において、測定するチップ がウエハマップの正しい位置に対応するか否かを 点検する方法に関する。

〔従来の技術〕

半導体装置の製造においては、ウエハが多くの 同一寸法に区分され、各区分に同じ素子が形成さ れ、ウエハ処理が終るとウエハは前紀各区分ごと に切断され、各区分が1個ずつのチップとなる。

ウエハ処理が終ると、各区分ごとにプローブカ ードを用いて測定をなし、その区分に形成された 素子が良品であるか否かを判定し、その結果はウ エハマップにメモリされる。以下説明の便宜上ウ エハの各区分をチップと呼称することにし、第3 図を参照すると、ウエハ31の各チップ32a, 32b.. ... についてなされた測定結果は、同図印のウエ ハマップ上に32a、32b....とメモリされる。なお 現在の一般的な測定方法によると、座標XYを図 示の如く定めた場合、最も左の量上のチップに始 まりYの下方向(Y歳方向)に測定し、最も下の チップの測定が終るとXを1つ右にずらし、次に Yの上方向 (Y増方向) に測定し、以下これを繰 り返す。この試験結果は良品か不良品のいずれか であるが、図には簡単のため黒点を付して示す。 このようにして作成されたウエハマップに従って 不良チップになんらかの表示を付けておくと、ウェハをチップごとに切断したときに不良チップが容易に利別されるようになる。

(発明が解決しようとする問題点)

ウェハマップの現実の作成に限しては、上述した如くウェハマップが作成されないことがあり、第3図(a)の如くにプローブカードが測定したにもかかわらず、現実にはウェハマップが同図(のに示される如くに形成されること、すなわちウェハマップの座標のずれが発生することがある。そこで、第3図(a)の如きウェハマップが得られたときは再度測定をしなければならない問題がある。

(問題点を解決するための手段)

本発明は、上記問題点を解消したウェハマップ の座標点検方法を提供するもので、その手段は、 プロパー、プローブカード、テスタを用いてウエ ハ測定をなしその結果をウェハマップに書き込む において、測定チップの座標を、当該チップの周 囲のし字型判定パターンに測定データが入ってい るか否かによって点検し、座標ずれがあるときは

チップに関接するチップのうち測定済のチップ(それは測定データが入っているから $^{\circ}$ 1 $^{\circ}$ の状態 をとる)はそれぞれ(y+1, x-1)。(y x-1)。(y-1, x y y-1, y y-1, y y-1, y y-1, y-1, y-1, y-1, y+1, y-1, y-1, y+1, y+1, y-1, y+1, y+1,

他方、プローブカードがY輪を下方向に(Y波方向)動く場合のウェハマップは第1図のに示され、このとき、连欄(x, y)にあるチップに隣接するチップのうち、測定済(*1 *)のチップはそれぞれ(y1, x2)。(y1, x2)。(y2, x2)。(y1, x1)。の座標にあり、未測定(*0 *)のチップはそれぞれ(y1, x1)。(y2, x1)。(y2, x1)。(p2, x1)。の座標にある(第1図(40の場合との混同を回避する目的で、x,yの増はx1, y1 で、x,yの減

前記し字型判定パターンによって修正することを 特徴とするウエハマップの座標点検方法によって なされる。

(作用)

上記方法においては、プローブカードの進行方向に対して定められた座標を点検し、各座標が測定済(*1 *の状態)か未判定(*0 *の状態)かを判定し、その判定結果を前以って定められた*1 *と*0 *のパターンと比較して座標ずれを判定し、座標ずれがあれば前記比較の結果に従って測定結果を正しい座標に配入するものである。

(実施例)

以下、図面を参照して本発明実施例を詳細に説明する。

第1図(a)と(b)に本発明の方法の実施を示すウエハマップが示され、XY連標は図示の如くにとる。 先ず、第1図(a)を参照すると、それはプローブカードがY軸を上方向に (Y増方向) 動く場合を示す。 ウェハマップにおいて測定中のチップの座標が (x,y) であるとすると、座標 (x,y) の

は x 2 , y 2 で示した)。この状態は第1図(4)に 示され、図において矢印は Y 増方向であることを 示す。

第1図(のと何のパターンから、同図(の)、(パに示される基本的にはL字型の判定パターンが得られる。 Yが減方向の場合には、測定中のチップに対して、当該チップのまわりの上下逆のL字型パターンがすべて"1°、また左右逆のL字型パターンが"0°であれば、測定チップの結果はウェハマップの正しい位置に記入されることになる。

Yが増方向のとき、"1°の判定パターンはL 字型パターン、"0°の判定パターンは上下左右 逆のL字型パターンである。

このようにして、"1" 判定パターンと"0" 判定パターンを点検することによって、ウエハマップのアドレス (座標) ずれを完全に点検することが可能となり、また、各測定チップごとに点検を行うのであるから、ずれたアドレスを修正することも可能になる。

上記の方法を実施するには、第2図のブロック

図を参照すると、プローバ11からテスタ14に座標 データを送り、ウエハマップを作ってテスタ14で それをメモリする。 プローブカード12でウエハ13 のチップを測定した結果もまたテスタ14に入力される。 プローブカードがある座標 (x,y) のチップに来たときは、テスタ14で前記した L 字型パターンに使ってウエアマップを走査し、"1"と のの信号が L 字型パターンに合致していると 測定を行い、ずれているときは必要な修正をなす。

なお、上述の説明は、Y方向の増、減についてのものであったが、本発明の方法はX方向に増、減の場合も全く間様に実施可能である。

(発明の効果)

以上説明したように本発明によれば、測定チャ ア座様(アドレス)の周囲のチップのアドレスを し字型制定パターンを使用することによって点検 することができるので、座標ずれが出たときはウ エハマップを修正し測定を継続することが可能と なるので、ウェハマップの信頼性を向上する効果 がある。 4.図面の簡単な説明

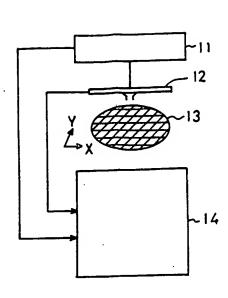
第1図(a)と(b)は測定チップの周囲のウェハマップを示す図、同図(a)と(d)は(a)と(b)に対応する測定済、未測定状態を示す図、同図(a)と(f)は(c)と(d)に基づく利定パターンの図、第2図は本発明方法を実施するシステムのプロック図、第3図(a)はウェハのチップを示す平面図、同図(b)は(a)のチップを正しく示すウェハマップの図、同図(c)は誤って作られたウェハマップの図である。

図中、11はプロバー、12はプローブカード、13はウエハ、14はテスタ、をそれぞれ示す。

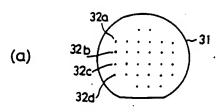
(a) y = 1 (c) y = 1 (d) y = 1 (e) y = 1 (e) y = 1 (f) y = 1 (f) y = 1 (g) y = 1 (e) y = 1 (f) y = 1 (f)

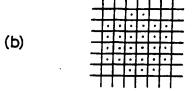
第1回

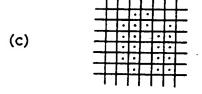
特開昭61-171147(4)



第2四







第3回